**Технологические комплексы интегрированных процессов производства изделий электроники**

**Монография**

**Достанко А.П.1, Аваков С.М.2, Агеев О.А.3, Батура М.П.4, Бордусов С.В.5, Голосов Д.А.6, Джуплин В.Н. «Foreign»7, Завадский С.М.8, Клим О.В. «Foreign»9, Ланин В.Л.10, Мадвейко С.И.11, Мельников С.Н.12, Петухов И.Б. «Foreign»13, Ретюхин Г.Е. «Foreign»14, Русецкий А.М. «Foreign»15, Титко Д.С. «Foreign»16, Томаль В.С. «Foreign»17, Трапашко Г.А. «Foreign»18, Чередниченко С.Б. «Foreign»19, Школык Д.И. «Foreign»20**

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

**Источник:** Минск : Беларуская навука, 2016. – 251 с.

**Аннотация.** Рассмотрены и обобщены результаты исследований и разработок в области создания и функционирования современных технологических комплексов интегрированных процессов производства изделий электроники, начиная от очистки поверхности подложек ультразвуком, СВЧ-плазмохимической обработки, магнетронного электронно-лучевого и импульсного лазерного формирования структур и состава слоев, высокочастотного локального нагрева, диффузионной сварки, а также интегрированного контроля микро- и наноструктур.

 Монография предназначена для инженерно-технических работников предприятий электронной и других отраслей промышленности, специалистов научно-исследовательских институтов, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов технических вузов.

**Интернет-ссылка:** <http://www.belnauka.by/component/mtree/knizhnye/978-985-08-1993-2.html>